

Judul:

Studi pengaruh temperatur curing dan ketebalan adhesive terhadap kekuatan geser dan kelupas pada adhesive paduan epoxy dengan menggunakan adherend lembaran baja karbon rendah SPCC-SD

Pengarang/Penulis:

Herman Farid, author

Subjek:

Epoxy Resins ; Adhesive joints

Nomor Panggil:

S40810

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)